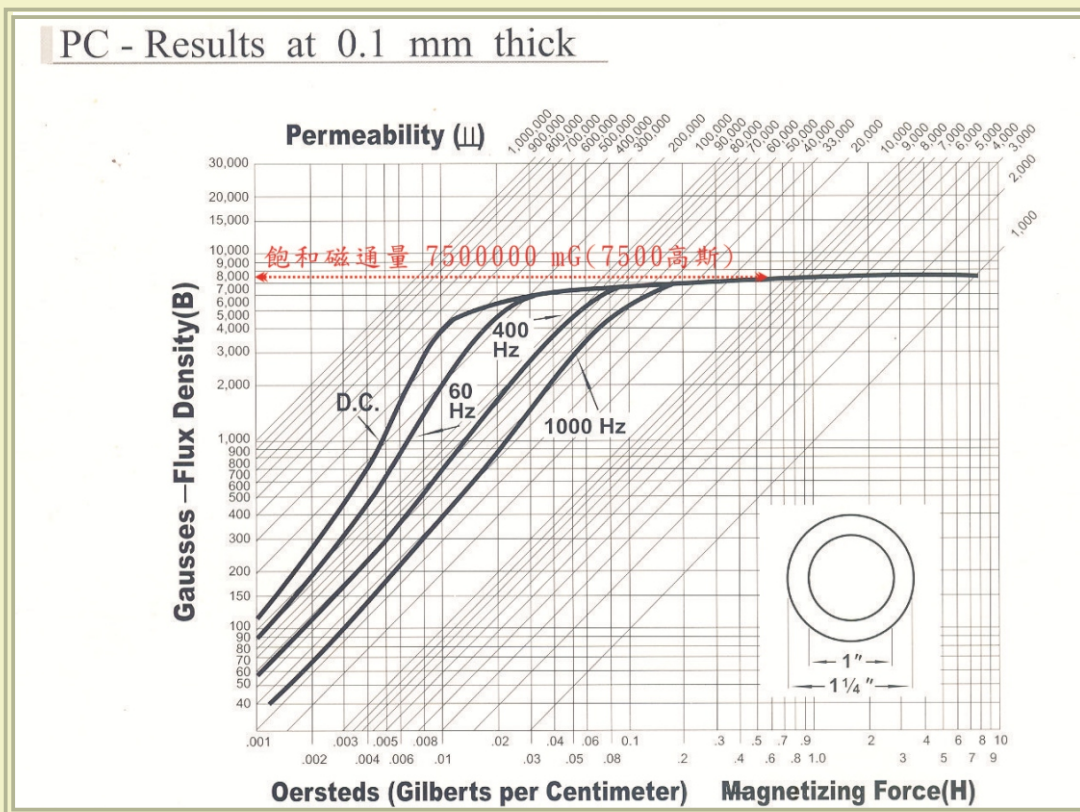


交流磁場遮蔽複合板 MSB-8010D

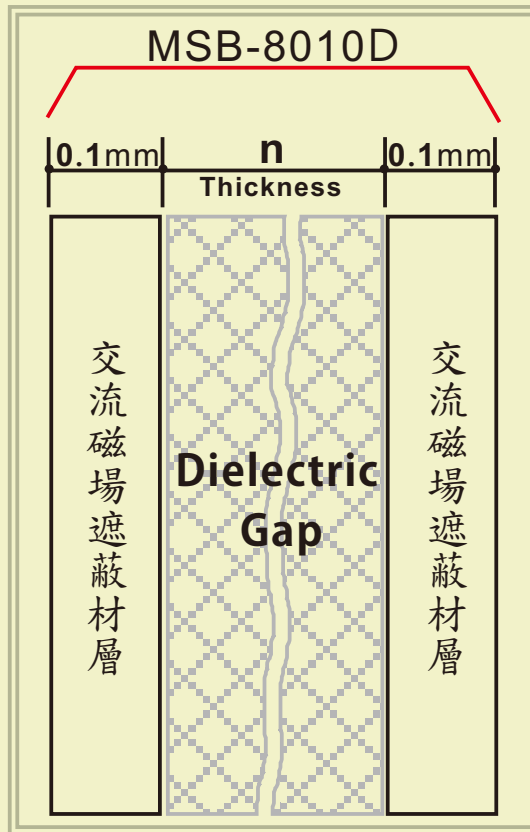
Product Introduction

- 遮蔽DC磁場
- 遮蔽交流磁場
- 變電設備、電源箱專用防磁材料
- 電線纜及匯流排專用防磁線槽
- 變頻器、UPS專用防磁材料
- 台電、自用配電室磁場防護
- Power Room、IT Room磁場防護

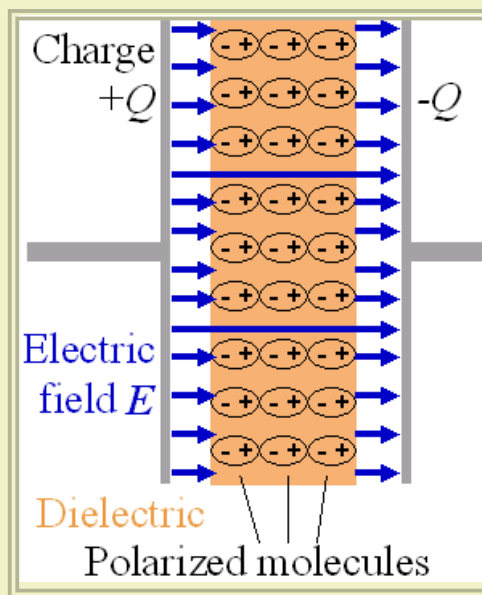


頻率	初導磁率	最高導磁率
60Hz Magnetic Field	89,700	307,000


JPC-8010 高導磁特性表




Certain Material Gap 厚度= n 作為介電質(Dielectric)複合於平行交流磁場遮蔽材層間，由於電場將介電質粒子極化，產生與電容器電場成反向（反平行）的電荷群於平行板表面上，電荷在平行板間產生一比沒有介電質時更弱的電場，從而減少電勢。



交流磁場遮蔽材 **Model JPC-8010 (0.10mm \times 2層) With Dielectric Gap between** 除緩沖衰減磁場外並積層大幅提升磁場隔離效能作用。

 厚度規格：

層數	材質	厚度
第一層	交流磁場遮蔽材 JPC-8010	0.1mm±0.005mm
第二層	Dielectric Gap	n=6mm±0.2mm
第三層	交流磁場遮蔽材 JPC-8010	0.1mm±0.005mm
	TOTAL	6.5mm(About)

 每平方米重量規格：

層數	材質	每平方米重量
第一層	交流磁場遮蔽材 JPC-8010	0.88kg±0.005kg
第二層	Dielectric Gap	5.4~6.6kg (C.S.B if)
第三層	交流磁場遮蔽材 JPC-8010	0.88kg±0.005kg
	TOTAL	7.16~8.36kg(About)

 隔離效率(Shielding Efficiency)：

依據工業技術研究院50 Hz至60 Hz電磁波遮蔽測試報告09854C01278-1-1-01

交流磁場遮蔽效率：

頻率	交流磁場隔離遮蔽效率
60 Hz 交流磁場	42.3 dB

交流磁場遮蔽率：

頻率	交流磁場遮蔽率
60 Hz 交流磁場	99.9941 %

MSB-8010D 物理特性：

項次	項目	特性	
		縱向	橫向
1.	抗彎強度 (kg f/cm ²)	143 以上	72 以上
2.	防火／耐燃性能	通過 CNS 6532 耐燃一級	
3.	耐污染性 表面油脂(Grease)塗佈經由汽油(Gasoline) 擦拭	無異狀、不腫脹	
4.	耐黴性	無異狀	
5.	耐熱 120°C	無異狀 不會影響磁場遮蔽效果	
6.	耐酸性 1%硫酸測試(24hr)	無腐蝕	
7.	耐鹼性 3%氫氧化鈉測試(24hr)	無腐蝕	
8.	抗氧化	不生鏽	

MSB-8010D 規格特性：

項次	項目	特性
1.	硬度	HV 170
2.	矯頑力(Hc)	0.005A/cm
3.	飽和磁通密度(Bs)	7500 Gauss
4.	方向性效應	無方向性 施工不需辨認方向性 方向性效應不會影響磁場遮蔽效果
5.	居里溫度	460°C 沒有自發磁化強度消失問題
6.	外加磁場	不會自發改變內部分子結構而影響磁場遮蔽效果，本材料為矯頑力(Hc)很低的軟磁材料所以退磁性強。
7.	飽和磁化作用	本材料飽和磁通量為 7500000 mG(7500 高斯)常態環境無法達到 7500 高斯所以不受飽和磁化影響。
8.	自發性昇溫	本材料遮蔽磁場不會發熱
9.	長久性使用特性	本材料永久性不會變質，不會有遮蔽效果衰退現象。
10.	RoHS 檢測要求	檢測鎘、鉛、汞、六價鎘、多溴聯苯、多溴聯醚含量均符合檢測標準。(CE/2008/57562)



測試名稱：電磁波遮蔽測試

測試結果與說明

一、測試結果

單位：(dB)

品名 \ 頻率	50HZ	55HZ	60HZ	參考
交流磁場遮蔽複合板 (MSB-8010D)	38	40.5	42.3	電磁波 遮蔽材料

二、測試說明

1.

本測試作業係於 2009 年 5 月 18 日於工研院材化所 77 館 465 實驗室執行。

2. 測試方法:

2.1 本測試之實施依據為 "ASTM D4935-99 測試規範執行測試。

3. 測試用標準件/或測試用儀器

3.1 本次測試所使用之標準件為頻譜分析儀，序號為 8567A。

3.2 本次測試所使用之為量測儀器信號產生器，序號為 8647A。

工業服務



儀器名稱	序號
頻譜分析儀	8567A
信號產生器	8647A
...	

5. 環境條件

本實驗室之環境溫度為 25°C、相對濕度為 73%

本報告
2009/5/20